

2010-2011年全球及中国晶振行业研究报告

所有数字电路都需要使用晶振，晶振每年的出货量惊人。2009年晶振的出货量大约120亿颗，2010年增长25%达到150亿颗。不过晶振的价格竞争一直没有停止，这导致晶振销售额并没有增加太多，2010年晶振市场规模为38.98亿美元，比2009年增长了14.3%，这是晶振行业近十年来增幅最高的一年。

尽管对CMOS晶振和MEMS晶振研究了很多年，尽管它们具备很多优点，但是晶振主流产品还是几十年没变的石英（QUARTZ）晶振。CMOS晶振和MEMS晶振累计出货量还不到1亿颗，不及石英晶振的百分之一。

日本是晶振产业霸主，日本晶振行业产值占全球晶振行业产值的67%，这个比率一直维持了十几年。日元升值和日本地震都无法动摇日本企业在晶振行业内的地位和产值。

2010年全球晶振厂家收入排名中，前四名均为日本企业。台湾和美国厂家也在晶振产业占据重要地位，2010年收入排名前21位中，有7家为台湾厂商，4家为美国厂商。

从2010年与2009年收入对比来看，Epson Toyocom、Rakon、TXC、HELE、SIWARD、TAISAW等厂商增长迅速，而TEW、Pericom则出现了下滑。总体上讲，大多数日本晶振企业稳定增长，大多数台湾晶振企业增长较快，而大多数美国晶振企业增长较慢或下滑。



2010年全球21大晶振厂家收入排名

厂商	地区	2010 年收入 (百万美元)	2009 年收入 (百万美元)	增幅
Epson Toyocom	日本	949	655	44.9%
NDK	日本	626	597	4.9%
KDS	日本	415	343	21.0%
Kyocera Kinseki	日本	358	317	12.9%
TXC	台湾	301	223	35.0%
Vectron	美国	205	202	1.5%
Rakon	新西兰	180	120	50%
HELE	台湾	165	112	47.3%
HOSONIC	台湾	109	110	-0.9%
TEW	日本	66	70	-5.7%
River	日本	65	55	18.2%
TAITIEN	台湾	59	54	9.3%
Pericom	美国	46	53	-13.2%
Micro Crystal	瑞士	57	50	14%
SIWARD	台湾	70	46	52.2%
TATSAW	台湾	60	42	42.9%
JINGYUAN YUFENG	中国大陆	50	40	12.5%
EAST CRYSTAL	中国大陆	44	32	37.5%
CONNER-WINFIELD	美国	39	35	11.4%
FOX	美国	38	34	11.8%
AKER	台湾	19	14	35.7%



报告目录

第一章 晶振简介

第二章 晶振市场

2.1手机市场

2.2手机厂家市场占有率

2.3智能手机市场与产业

2.4其他市场

2.5 晶振市场规模

2.6 晶振产品未来趋势

2、高频化

第三章 晶振产业

3.1 晶振产业排名

3.2晶振行业细分市场占有率

3.3日本晶振行业

3.4 MEMS振荡器与全硅振荡器

3.4.1 MEMS振荡器简介

3.4.2 全硅振荡器简介

3.4.3 Sitime

3.4.4 Discera

3.5 QMEMS

第四章 晶振厂家研究

4.1 Epsontoyocm

4.2 NDK

4.3 Kyocera Kinseki

4.4 KDS

4.5 Vectron

4.6 晶技

4.7 TEW

4.8 Rakon

4.9 River

4.10 Pericom

4.11 希华



4.12 加高

4.13 唐山晶源裕丰

4.14 泰艺

4.15 安碁科技

4.16 台湾嘉硕科技

4.17 LGL Group

4.18 浙江东晶

4.19 大陆其他晶振公司

4.19.1 湖北东光集团有限公司

4.19.2 南京华联兴电子有限公司

4.19.3 台州雅晶



图表目录

- 2007-2014年全球手机出货量
- 2008年1季度-2011年1季度每季度全球手机出货量 与年度增幅
- 2007-2011年每季度CDMA、WCDMA手机出货量
- 2009-2010年全球主要手机品牌出货量
- 2009年1季度-2010年4季度全球五大手机厂家运营利润率
- 2011年1季度全球主要智能手机厂家市场占有率
- 2007-2012年全球无线基站出货量统计及预测
- 2007-2012年全球光通讯设备出货量统计及预测
- 2007-2015年车用石英元件需求
- 2006-2012年全球晶振市场规模
- 2001-2010财年晶振ASP统计及预测
- 1999-2010财年SMD型石英晶振尺寸结构比例
- 2004、2005、2006年全球前14大晶振厂家收入排名
- 2006-2008年全球前14大晶振厂家收入排名
- 2010年全球21大晶振厂家收入排名
- 2010年全球X'TAL 市场主要厂家市场占有率



- 2010年全球CXO市场主要厂家市场占有率
- 2010年全球TCXO市场主要厂家市场占有率
- 2010年全球VCXO/OCXO市场主要厂家市场占有率
- 2009年全球晶振产业产值地域分布
- 2005-2011财年日本晶振行业收入与增幅
- 2005-2011财年日本晶振收入与增幅
- 2005-2011财年日本晶振行业产量与增幅
- 2005-2011财年日本晶振行业产量及应用结构统计
- 2005-2011财年日本晶振行业收入及应用结构统计
- 2010-2014年晶振发展路线图
- MEMS振荡器技术路线图
- Si500S内部框架图
- Sitime公司MEMS振荡器示意图
- Epson Toyocom 2002-2011财年收入与营业利润统计
- 2007-2010财年Epsontoyocom收入产品分布
- 2007-2010财年Epsontoyocom收入产品下游分布
- Epson toyocom全球分布
- NDK业务组织结构



- 2003-2011财年NDK收入、运营利润统计
- 2009-2010年NDK收入地域分布
- 2010财年1季度到2011财年4季度NDK收入、运营利润统计
- 2009-2010财年NDK收入下游应用分布
- 2005-2009财年上半年NDK产品出货量与产品结构
- 2005-2009财年上半年NDK收入产品分布
- 2006-2009财年上半年NDK收入产品下游分布
- 2006-2010财年NDK研发经费
- 2006、2007财年Kyocera Kinseki收入与税前利润统计
- Kyocera Kinseki长期经营目标
- 2009-2010财年京瓷收入部门分布
- 2010-2011财年KDS收入地域分布
- 2011财年KDS产值地域分布
- 2009-2011财年KDS收入产品分布
- 2007-2010财年KDS收入产品下游分布
- 2005-2010财年KDS收入与运营利润
- 2005-2010财年KDS收入与净利润
- TXC Milestone



- 2002-2009年晶技收入
- 2007-2012年TXC收入与营业利润率
- 2008年1季度-2011年1季度晶技收入与增幅
- 2008年1季度-2011年1季度晶技毛利润与增幅
- 2006、2007年晶技产品下游 应用比例结构
- 2008、2009晶技产品下游 应用比例结构
- 2010、2011晶技产品下游 应用比例结构
- 2006、2007年晶技产品下游具体应用比例结构
- 2006、2007年晶技产品技术类型结构
- 2008、2009年晶技产品技术类型结构
- 2010、2011年晶技产品技术类型结构
- 2006年晶技客户结构
- 晶技产品与技术战略
- 晶技产品尺寸分布
- 晶技各工厂产能
- 台晶2006年财务概况
- 2002-2009财年Rakon收入与EBITDA
- 2008-2009财年Rakon收入地域分布



- 2009财年1季度-2010财年2季度Rakon GPS级晶振销量与平均价格
- 2010、20011财年Rakon财务数据
- Rakon发展历程
- 2010-2011财年RAKON收入产品分布
- Rakon主要客户
- Rakon主要芯片组合作伙伴
- 2003-2011财年River收入与营业利润率
- 2008-2011财年RIVER收入地域分布
- RIVER 2010-2011财年产品下游应用比例
- RIVER 2006-2009财年产品下游应用比例
- 2005-2011财年Pericom收入与运营利润
- 2008-2011财年Pericom收入地域分布
- 2008-2011财年Pericom部门收入分布
- 2002-2010年希华收入与毛利率统计
- 2007-2009年希华地域收入结构
- 2009-2011年希华产能
- 2009年希华产品下游应用比例
- 2009-2011年希华收入产品分布



- 2010年1季度-2011年4季度希华收入产品分布
- 2004-2011年加高收入与毛利
- 1991-2007年晶源裕丰产量产值统计
- 2004-2010年唐山晶源裕丰收入与运营利润
- 2004-2011年泰艺电子收入与毛利率
- 2006-2011年 泰艺电子收入产品分布
- 2006-2011年 泰艺电子收入产品下游应用分布
- 2002-2010年安碁科技收入
- 安碁科技产品线
- 安碁科技产品下游应用比例
- 安碁科技汽车用晶振一览
- 安碁科技技术能力一览
- 安碁科技制程能力
- 2005-2011年嘉硕科技收入与毛利率
- 2010年4季度嘉硕收入产品分布
- 2010年3季度嘉硕收入产品下游分布
- 2010年3季度嘉硕收入地域分布
- 2005-2010财年LGL收入



- 2008年2季度-2011年1季度LGL收入、毛利率与EBITDA
- 东晶电子组织结构
- 2005-2010年东晶电子收入与运营利润

- 2010年1季度-2011年1季度全球主要手机品牌出货量
- 2009年1季度-2010年3季度全球主要手机品牌收入市场占有率
- 2010年3季度全球智能手机操作系统出货量
- 2010-2011财年NDK收入产品分布
- 2010年晶源裕丰收入产品分布
- 2010年晶源裕丰收入地域分布
- 2010年晶源裕丰前五大供应商
- 2010年晶源裕丰前五大客户
- 2010年东晶电子各项产品收入与毛利率



购买报告

价 格	电子版：8000元	电话：010-8260.1561/62/63
	纸质版：8500元	传真：010-8260.1570
页数：126页	邮箱：hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期：2011-06	网址：www.pday.com.cn	
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201106/24511298.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		



如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

